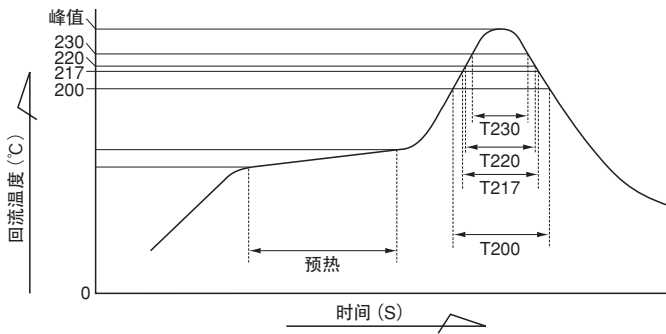


回流焊接的推荐条件



T200 : 电容器表面超过+200°C的时间
 T217 : 电容器表面超过+217°C的时间
 T220 : 电容器表面超过+220°C的时间
 T230 : 电容器表面超过+230°C的时间
 温度测量点: 铝壳头部
 超出容许范围使用时请咨询我们。

No.	品种·系列名称	尺寸	预热	峰值温度	超过 230°C 的时间	超过 220°C 的时间	超过 217°C 的时间	超过 200°C 的时间	回流次数
1	芯片型导电性高分子 铝固体电解电容器 (PCF, PCJ, PCK, PCG, PCS, PCL, PCV, PCX, PCR, PCM, PCH, PCZ)	-	150 ~ 200°C, 60 ~ 180秒 以内	260°C Max.	60s 以内	-	70s 以内	-	仅限1次 (部分系列※4 2次以内※5)
		-		250°C Max.	60s 以内	-	70s 以内	-	2次以内※5
2	导电性高分子 混合铝电解电容器 (GYA, GYB, GYC, GYD, GYE)	-		260°C Max.	40s 以内	-	50s 以内	-	仅限1次
		-		250°C Max.	30s 以内	-	40s 以内	-	2次以内※5
3	芯片型铝电解电容器 (UZS, UZT, UWX※1, UWR, UWP※1, UWT※1, UWF, UWG, UUP, UUT, UUA, UUL, UCB, UCW, UCD※2, UCL, UCM※2, UCV, UUD, UUB※3, UCJ, UCZ※2, UCH, UCX※2, UUR, UUX※3, UUQ, UCQ, UUE※2, UBC※2, UBH)	~φ10		250°C Max.	30s 以内	-	40s 以内	-	2次以内※5
4	芯片型铝电解电容器 (UWX, UWP, UWT)	φ8×5.4L	150 ~ 180°C, 120秒以内	245°C Max.	-	30s 以内	30s 以内	-	2次以内※5
5	芯片型铝电解电容器 (UZR, UZG)	3.9L		240°C Max.	-	30s 以内	30s 以内	-	2次以内※5 (φ6.3:仅限1次)
6	芯片型铝电解电容器 (UUX (160-400V), UUB (160-400V), ULT, ULH, ULR, ULV)	~φ10		240°C Max.	-	30s 以内	30s 以内	-	2次以内※5
7	芯片型铝电解电容器 (UCD, UCM, UCZ, UCX, UUG, UUJ, UUN, UUE, UBC)	φ12.5 ~		240°C Max.	-	-	30s 以内	60s 以内	2次以内※5
8	芯片型铝电解电容器 ※6 (UWJ, UWZ, UWD, UWH)	-		260°C Max.	60s 以内	-	70s 以内	-	2次以内※5 (φ8×6.2L和 φ10×10L: 仅限1次)

s = 秒

- ※1: φ8×5.4L请参照No.4.
- ※2: φ12.5 ~ 请参照No.7.
- ※3: 160 ~ 400V请参照No.6.
- ※4: 包括PCR, PCM, PCH 和 PCZ系列.
- ※5: 请在第1次和第2次回焊之间留出充分的产品冷却时间.
- ※6: 高温回流对应品.

关于商品目录中记载的ESR阻抗值

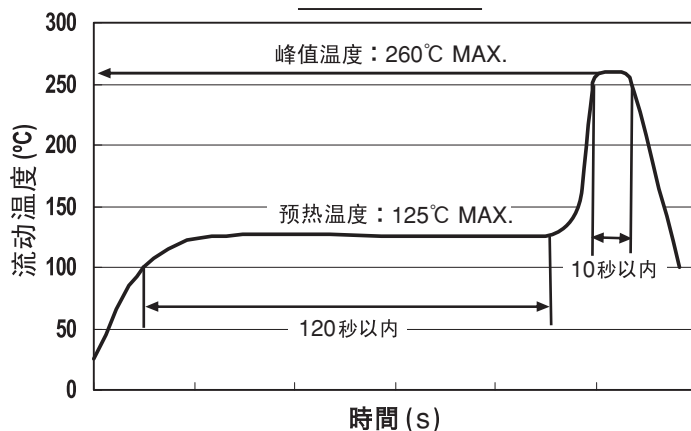
引线型: 测定位置为引线端子底部。
 芯片型: 测定位置为距离树脂板的孔口最近的电极部。

FPCAP 无铅及RoHS指令适合焊接条件

流动焊 (引线型)

RNS、RR7、RR5、RL8、RE5、RS8、RF8、RNU、RNE、RNL、RS6、RHT

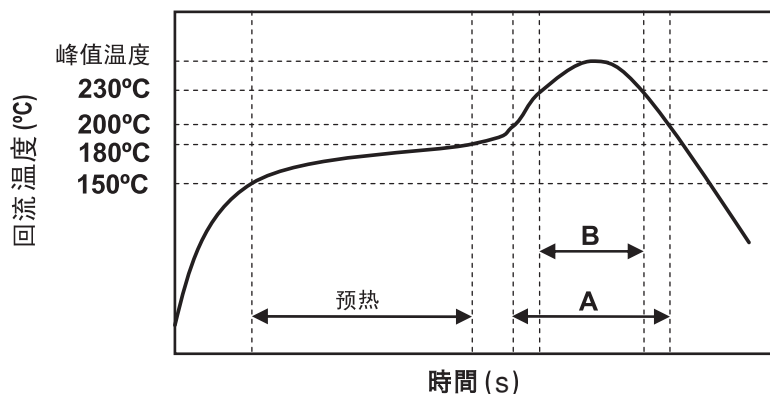
推荐流动条件



回流焊 (芯片型)

RPS、RPA、RHS、RHA、RSS、RSA、RSB、RFS、RFA、RSL

推荐回流焊条件



項目	推荐条件 1	推荐条件 2
峰值温度	260°C MAX.	250°C MAX.
预热	150~180°C 90秒以内	150~180°C 90秒以内
A	200°C 以上 60秒以内	200°C 以上 60秒以内
B	230°C 以上 40秒以内	230°C 以上 40秒以内
回流次数	1次	2次以下